МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет електроніки та інформаційних технологій

Кафедра наноелектроніки

Кваліфікаційна робота бакалавра

Зі спеціальності 153 – «мікро- та наносистемна техніка»

на тему:

«Позитронно-анігіляційний аналіз наноструктурних функціональних матеріалів»

Студент гр. ФЕ-61

Я.М. Левченко

Науковий керівник,

Старший викладач

А.А. Багдасарян

Реферат

Об'єктом дослідження бакалаврської роботи є метод ПАС для аналізу наноструктурних функціональних матеріалів.

Мета роботи полягає у визначенні характеристик і структур досліджуваних матеріалів.

Під час виконання роботи використовувалися: схеми установок для дослідження анігіляції позитронів.

Робота складається з 4-х розділів, де:

в 1-му розділі описується метод позитронної анігіляційної

спектроскопії, та характеристики позитрона;

• в 2-му розділі описується позитронна анігіляція в металах, методика та результати експериментів;

• в 3-му розділі проводиться дослідження термічної стабільності наноструктурних покриттів за допомогою анігіляції позитронів;

• в 4-му розділі проведено аналіз основних правил техніки безпеки при

роботі за персональним комп'ютером.

Робота викладена на 51 сторінці, робота містить 10 рисунків, 2 таблиці та список цитованої літератури із 70 джерел.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОЗИТРОН, ПАС, АНІГІЛЯЦІЯ, КРАФ

Зміст

Вступ	4
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	6
1.1 Позитрон та його характеристики	6
1.2 Теорія методу ПАС	9
1.3 Вимірювання часу життя позитронів в речовині	13
1.4 Методи визначення ймовірності Зү–анігіляції позитронів	16
 1.5 Визначення ймовірності 2ү-анігіляції позитронів 	17
1.6 Допплерівське розширення анігіляційної лінії	23
РОЗДІЛ 2. АНІГІЛЯЦІЯ ПОЗИТРОНІВ В МЕТАЛАХ	24
2.1 Методика, теорія і результати експериментів	24
2.2 Особливості спектрів КРАФ досліджених металів	27
2.3 Визначення концентрації електронів n _p в зоні провідності металу	28
РОЗДІЛ З ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТ	ГТІВ 34
РОЗДІЛ 4 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ П ПРИ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП'ЮТЕРОМ	РАЦІ 43
Висновки	46
Список використаних джерел	48

Вступ

В даній дипломній роботі було розглянуто порівняно новий метод вивчення будови речовини – метод позитронної анігіляційної спектроскопії (ПАС), що включає в себе вимір часу життя позитрона, методи визначення ймовірностей 3ү- і 2ү-анігіляцій позитронів, вплив на основні характеристики анігіляції різних зовнішніх факторів. Були проаналізовані особливості процесу анігіляції позитронів покриттів та металів, можливості і перспективи ПАС для вивчення їх електронної та дефектної структури.

Цікавість до вивчення позитроніки не випадкова, оскільки з одної точки зору вона пов'язана з основними проблемами фізики, такими як, народженням і еволюцією Всесвіту [11], позитронною астрофізикою [11, 13, 14], взаємодією речовини і антиречовин. З іншого боку, цікавість до позитроніки пов'язана з пошуком нових незвичних методів дослідження електронної структури і деяких фізико-хімічних характеристик речовини [1–12, 16–18, 19–52] (в тому числі і твердих тіл), а також можливостей побудови приладів і пристроїв, працюючих на основі ефектів взаємодії випромінювання з речовинами.

Даний метод використовується для дослідження електронної структури, структури природи і концентрацій точкових і протяжних дефектів, вивчення поверхневих шарів металів, та інших речовинах. Провівши ряд експериментів було знайдено ряд нових ефектів в позитронних анігіляційних спектрах, існування кількох часів життя позитронів, тонку структуру кривих кутового розподілу анігіляційних фотонів, збільшену імовірність трьохквантової анігіляції.

Результати, які були отримані під час роботи з методом ПАС збільшують цікавість до подальших експериментальних і теоретичних досліджень та до аналізу позитронних станів, процесів і позитронній анігіляції з метою систематизації вже накопиченого матеріалу, класифікації позитронних станів та опису їх властивостей, впливу на них різних зовнішніх факторів (магнітного поля, температури, тиску і т.д.), а також більш чіткого з'ясування можливих застосувань позитронного методу.

На даний час аналізують нові можливості і перспективи використання позитронної анігіляційної спектроскопії для вивчення електронної та дефектної структури різних речовин, в радіаційної фізики та хімії, та у фізиці та хімії розчинів. Встановлення механізму утворення позитронів в діелектричних середовищах робить метод ПАС досить ефективним інструментом для вивчення фізико-хімічних характеристик первинних продуктів радіолізу.

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Позитрон та його характеристика

Найголовнішим елементом методу ПАС є позитрон. Позитрон являє собою елементарну частинку з позитивним електричним зарядом, що є античастинкою відносно електрона. Електрон та позитрон мають однакові масу, спіни, електричні заряди та магнітні поля, але тільки за величиною, а відмінність їх в тому, що вони мають протилежні знаки. Позитрон (як і електрон) є ферміоном (квазічастинкою з напівцілим значенням спіна), відноситься до класу лептонів (фундаментальні частинки з напівцілим спіном, які не беруть участь у сильній взаємодії) і бере участь в електромагнітній, слабкій і гравітаційній взаємодії. У порожнечі позитрон стабільний. Однак в речовині існує короткий час $10^{-8} - 10^{-6}$ с, оскільки, стикаючись з електроном, зникає разом з ним, перетворюючись в два гамма-кванта

 $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$

Позитрон є античастинкою по відношенню до електрона, Після імплантації (потрапляння) в тверде тіло позитрон швидко втрачає вихідну кінетичну енергію і термалізуєтся (протягом 3 пс). Наступним чином позитрон починає блукати в кристалічній решітці і в процесі таких блукань через відштовхування з боку позитивно заряджених іонних частинок і тяжіння до електронів провідності локалізується переважно в міжвузловому просторі. В наслідок чого , в досконалому кристалі позитрон буде знаходитися в основному в делокалізованному стані, тобто ймовірність перебування частинки на великій відстані від будь-якої точки простору скінченна.

Всі елементи відрізняються один від одного, та характеризуються унікальними спорідностями до позитрону, і позитрон може також

локалізуватися в областях з підвищеною спорідненістю. Деякі елементи мають підвищену спорідненість, це такі речовини, як: : Fe, -3.84 eB; Cu,-4.81 eB; Ni, -3.72 eB; Mn, -3.72 eB. Як наслідок, кластери, що складаються з 5 – 10 атомів міді в матриці заліза, можуть захвачувати позитрон. Тому іншими локальними об'єктами, які можуть ефективно досліджуватися за допомогою позитронів, є компактні виділення атомних компонентів з підвищеною спорідненістю до позитрону.

Метод ПАС має в основному три методи вимірювань:

1) тимчасовий розподіл анігіляційних фотоні

2) кутовий розподіл анігіляційних фотонів;

3) допплерівське розширення анігіляційної лінії з енергією 0.511 МеВ

Перший метод дає відомості про електронну густину щільності в місці анігіляції позитрона, два інших – інформацію про розподіл імпульсів електронів і про хімічний склад середовища, навколишніх нанооб'єктів в місці анігіляції.

Час життя позитрона τ визначається перекриттям щільності електрона n+(r) і позитрона $n+(r)=|\psi + (r)|^2$ в області локалізації останнього

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = \pi r_0 c^2 \int |\psi_+(r)|^2 n_{(r)\gamma} dr$$
(1.1)

де кореляційна функція

$$\gamma = \gamma[n_{r}(r)] = 1 + \Delta n_{r}/n_{r} \tag{1.2}$$

описує збільшення електронної густини внаслідок кулонівського тяжіння до позитрона, а r₀ – класичний радіус електрона. Оскільки локальні вільні обсяги характеризуються меншою електронною густиною порівняно з бездефектними областями, то час життя позитрона в цьому дефекті буде більше, ніж наприклад в досконалому кристалі. При цьому кожен дефект має

власний час життя τ_j , а інтенсивність I_j відповідні компоненти в сумарному експериментальному спектрі пов'язана з концентрацією таких дефектів.

Як наслідок, залежний від часу спектр часу життя позитрона в зразку, що містить *k* різних позитронно–чутливих дефектів, має вид

$$N(t) = \sum_{i=1}^{k+1} \frac{l_i}{\tau_i} \exp\left(-\frac{t}{\tau_i}\right)$$
(1.3)

і інформацію як про тип, так і про концентрацію дефектів можна отримати в єдиному експерименті.

Певні анігіляційні характеристики довготривалих компонентів спектра можуть бути інтерпретовані в рамках запропонованої Брандом моделі вільного об'єму. Зокрема, в [3] для дефектів сферичної форми була отримана проста функціональна залежність часу життя позитрона від радіуса сфери R, яким апроксимується дефект

$$\lambda = \lambda_b \left[1 - \frac{R}{R + \Delta R} + \frac{1}{2\pi} \sin(\frac{2\pi R}{R + \Delta R}) \right]$$
(1.4)

де λb – швидкість анігіляції позитрона в досліджуваному матеріалі, а параметр моделі $\Delta R = 0,1656$ нм – товщина однорідного електронного шару на поверхні пори, в якому відбувається анігіляція.

Для методу ПАС, так і для більшості методів аналізу, постійна зацікавленість представляє завдання поліпшення їх метрологічних характеристик, зокрема, завдання підвищення роздільної здатності. Один із методів вирішення може полягати в переході до нових схем вимірювання експериментальних спектрів.

1.2 Теорія методу ПАС

Позитронна анігіляція при зіткненнях з електронами супроводжується випусканням одного, двох або більше *γ*–квантів. Однофотонна анігіляція електрон–позитронної пари можлива лише в присутності третьої тіла (ядра, електронів),яка має здатність сприймає імпульс віддачі. При анігіляції вільних позитронів електрона повинно з'явитися хоча б два *γ*-кванта.

Зі збільшенням числа γ -квантів, перетин анігіляції позитронів швидко зменшується. При збільшенні числа випускаються γ -кванти, які на одиницю перетину анігіляції множиться на постійну тонкої структури $\alpha = 1/137$, тобто ймовірність процесу анігіляції зменшується більш ніж на два порядки.

Перетин 2*γ*-анігіляцій вільних позитронів і електронів було запропоноване Діраком. У нерелятивістському наближенні вказаний перетин зростає зі зменшенням відносної швидкості *v* стикаються частинок.[1,4]:

$$\sigma_{2\gamma} = \sigma_D = \pi r_0^2 \frac{c}{v} \tag{1.5}$$

де r₀ – класичний радіус електрона, *с* – швидкість світла.

При $\nu \to 0$ перетин σ_D стає нескінченно великим. Однак швидкість анігіляції λ_D позитрона іде до кінцевої межі.

$$\lambda_D = \sigma_D v n_e = \pi r_0^2 c n_e \tag{1.6}$$

в якому n_e - концентрація електронів.

При анігіляції електрон-позитронної пари використовуються закони збереження імпульсу і енергії, які при 2у–анігіляції мають вигляд

$$k_1 + k_2 = p = 2mv \tag{1.7}$$

$$k_1 c + k_2 c = E = 2mc^2 \tag{1.8}$$

Тут $m = m_0 / \sqrt{1 - v^2 / c^2}$, m_0 – маса спокою електрона, k_1 і k_2 імпульси γ квантів, E – енергія e^+ – пари, v – швидкість руху центру мас пари в лабораторній системі відліку.



Рис. 1.1 Схема розльоту γ-квантів при двухквантових анігіляції електронпозитронної пари [68]

З (1.7) і (1.8) випливає, що якщо центр мас пари в лабораторної системі відліку нерухомий (v = 0), то обидва γ -кванта розлітаються в протилежних напрямках (кут $\theta = 0$) з однаковою енергією: $k_{1c} = k_{2c} = m_0 c^2 = 0,511$ MeB.

При $v \neq 0$ кут між напрямками розльоту γ -квантів відрізняється на 180°, а їх енергія вже не дорівнює 0,511 МеВ. Якщо імпульс пари $p \ll m_0 c$, то кут θ (рис. 1) визначається співвідношенням

$$\sin\theta \approx \frac{p_{\perp}}{m_0 c} \tag{1.9}$$

а зміна енергії у-кванта (доплерівський зсув) задається виразом

$$\Delta E_{\gamma} \approx \frac{p_{\parallel}c}{2} \tag{1.10}$$

Таким чином, в разі 2*γ*-анігіляції вимір відхилення θ кута розльоту *γ*квантів змінюється від 180° або доплерівського зсуву анігіляційної лінії (0,511 MeB). Величина ΔE_{γ} дозволяє в принципі визначити імпульс e^+e^- пари в лабораторній системі відліку.

У разі потрійної анігіляції, закони збереження не визначають однозначно імпульси і енергії γ -квантів. При v=0 всі три γ -кванта випускаються в одній площині. Відхилення кутів розльоту (при $v\neq 0$) від цієї площини порядку v/c. На відміну від 2γ -анігіляції γ -кванти, що виникають при 3γ -анігіляції, мають безперервний потік розподілу по енергії від 0 до 0,511 МеВ.

У більшості речовинах процес анігіляції позитронів протікає через зв'язані стани позитронів з електронами, атомами, молекулами і різними дефектами. Найпростіша пов'язана двочасткова система *e*⁺*e*⁻ отримала назву "позитроній Ps"

Виявилося, що енергії зв'язку атома позитронія вдвічі менше, а радіуси орбіт вдвічі більше, ніж у атома водню:

$$E_n = -\frac{m_0 e^4}{4h^2 n_2} \tag{1.11}$$

$$r_n = \frac{2h^2 n^2}{m_0 e^2} \tag{1.12}$$

В основному стані атоми позитронія (n=1) енергія зв'язку $E_{ps}=-E_{1}=6.77$ ев, а Борівській радіус $a_{ps}=2a_{0}=0.106$ нм (де a_{0} – перший борівський радіус атома водню).

У нерелятивістському наближенні хвильові функції позитронія з поправкою на наведену масу ті ж, що і для атома водню. Так, для основного стану хвильова функція позитронія має вигляд

$$\psi_1(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_{Ps}^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_{Ps}}\right) \tag{1.13}$$

Залежно від взаємної орієнтації спінів e^+ і e^- розрізняють два основні стани атома позитронію: синглетний стан 1S_0 (парапозитроній *p*-*Ps*)коли спіни e^+ і e^- антипаралельні (сумарний спін дорівнює нулю), і потрійний стан 3S_1 (ортопозітроній *o*-*Ps*), коли спини e^+ і e^- паралельні (сумарний спін дорівнює одиниці).

Для ортопозитронія можливі три підстани, які розрізняються магнітними квантовими числами *m:+1,0,-1;* для парапозітроній *m=0*. Тому відносна статистична вага ортопозитронія дорівнює 3/4, парапозітронія 1/4

Перетин і характер анігіляції залежать від взаємної орієнтації спінів анігілюючих частинок. Так, парапозитроній відчуває 2γ -анігіляцію, а ортопозитроній 3γ -анігіляцію. Різними виявляються і ймовірності спонтанної анігіляції атом в *p*-*Ps* і *o*-*Ps*.

Швидкість анігіляції λ_s^0 і середній час життя щодо спонтанної анігіляції τ_s^0 парапозитроній в основному стані пов'язані співвідношенням

$$\lambda_s^0 = \frac{1}{\tau_s^0} = 4\pi r_0^2 c |\psi_1(0)|^2 \tag{1.14}$$

де $|\psi 1(0)|^2$ – ймовірність знаходження електрона в області розташування позитрона. Підставляючи (13) в (14), отримуємо

$$\lambda_s^0 8 \times 10^9 c^{-1}, \qquad \tau_s^0 1.25 \times 10^{-10} c$$
 (1.15)

з урахуванням відношення $\sigma_{3\gamma}/\sigma_{2\gamma} = 1/372$ а також ваги потрійного стану швидкість анігіляції ортопозитронія в основному стані

$$\lambda_t^0 = \frac{1}{\tau_t^0} = \frac{\lambda_s^0}{1115} = 7.14 * 10^6 c^{-1}, \quad \tau_t^0 = 1.4 * 10^{-7} c. \tag{1.16}$$

Зовнішнє магнітне поле призводить до розщеплення рівнів атома позитронію (ефект Зеймана) і так званого магнітного гасіння [1,4,12].

Найпоширенішим досліджуваним спостереження анігіляції позитронів в речовині є вимір середнього часу життя позитронів, спостереження кутової кореляції анігіляційних γ -квантів, визначення швидкості З γ -анігіляції позитронів. Існують і інші методи: вимірювання енергетичного спектра анігіляційного випромінювання (зокрема, доплерівського зсуву), поєднання вимірювання часу життя позитронів і кутової кореляції анігіляційних γ -квантів, і н. Розглянемо ряд основних з цих методів.

1.3 Вимірювання часу життя позитронів в речовині

Для визначення часу життя позитронів в речовині використовується нуклід ${}^{22}Na$ (з періодом напіврозпаду $T_{1/2} - 2,6$ року). Мета цього методу, це визначення часу життя позитронів, яке полягає в вимірюванні швидкості рахунку запізнілих збігів між ядерним γ -квантом з енергією 1,28 MeB (старт – початок відліку часу) переходу

$$^{22}Na \rightarrow ^{22}Ne + e^+ + \gamma(1.28 \text{MeB})$$

і одним з *γ*-квантів з енергією 0,511 MeB, випущених при анігіляції позитрона (стоп-сигнал). Позитрон і ядерний *γ*-квант (1,28 MeB) випускаються практично одночасно (інтервал часу не більше 10⁻¹¹ с) Таким чином, реєстрація ядерного *γ*-кванта (1,28 MeB) служить сигналом попадання позитрона в середовище, а *γ*-квант (0,511 MeB) свідчить про його загибель.

Схема установки для вимірювання часу життя позитронів приведена на рис. 2. Радіоактивне джерело 1 з активністю $(1-2)*10^6$ Бк випускає позитрони, які потрапляють в досліджувану речовину 2 і анігілюють в ньому. За допомогою сцинтиляційних детекторів 3 і 4 реєструються стартовий і

стоповий γ -кванти. Обидва детектора генерують сигнали S_1 і S_2 прив'язані в часі до випускання відповідних γ -квантів.



Рис.1.2. Схема установки для вимірювання часу життя позитронів [68]

Інтервал часу між подіями був виміряний за допомогою системи блоків наносекундної електроніки, яка включає детектори нуля в тимчасових каналах, блоки амплітудного аналізу і конвертор 5, що перетворює інтервал часу в амплітуду сигнала. Спектр тимчасового розподілу анігіляційних фотонів реєструється багатоканальним аналізатором імпульсів 6.

Приклад спектра часу життя позитронів в поліметилметакрилаті, показаний на рис. 3, демонструє, що в полімерних матеріалах позитрони живуть дуже довго (до 16 нс та більше), в той час як час життя позитронів в кремнії лежить в діапазоні 0,2–0,3 нс.



Рис.1.3. Спектр часу життя позитронів в поліметилметакрилаті [68]

Спостережуваний спектр являє собою суперпозицію декількох спектрів з різними часом життя:

$$N(t) = \int R(t, t_1) \sum_{i=1}^n A_i exp\left(-\frac{t_1}{\tau_i}\right) dt_1$$
(1.17)

(Тут R (t,t_1) – приладова функція установки часового розподілу анігіляційних фотонів, n – число компонент в спектрі, τ_i – час життя позитронів в речовині, A_i – частка позитронів з часом життя A_i

Напівширина (ширина на половині висоти) приладової функції в (1.17) для більшості сучасних установок лежить в діапазоні 0,2–0, 3 нс. Обробка спектрів на EBM (як правило, використовують програму PATFIT) дозволяє визначити часи життя позитронів в речовині, що лежать в діапазоні 0,1–30 нс, і ймовірності різних каналів анігіляції позитронів: *o-Ps*, *p-Ps*, *e*⁺ і т.д.

Час життя позитронів в речовині залежить від просторової густини електронів в районі анігіляції позитронів. При наявності вільного об'єму (пори) в речовині час життя позитронів визначається розміром пори [24]:

$$\tau = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{R}{R + \Delta R} + \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi R}{R + \Delta R} \right)^{-1}$$
(1.18)

де R – радіус пори, ΔR – товщина електронного шару ($\Delta R = 0,166$ нм).

Як видно з (1.18), метод тимчасового розподілу анігіляційних фотонів дозволяє отримувати інформацію дефектності речовини. Взагалі, вимірювання параметрів тимчасових анігіляційних спектрів (середніх часів життя τ_j інтенсивностей I_j) дає можливість судити про природу позитронних станів, механізмі анігіляції позитронів в середовищі і тим самим про властивості самого середовища.

1.4 Методи визначення ймовірності Зу-анігіляції позитронів

За відсутності створення позитронія відносна ймовірність Зу-анігіляції позитронів в $P_{3\gamma}^0 = 1/372$. При утворенні в речовині позитронія за рахунок Зу-анігіляції ортопозитронія відносна ймовірність Зу–анігіляції позитронія зростає: $P_{3\gamma} > P_{3\gamma}^0$. Тому вимір відносної ймовірності $P_{3\gamma}$ дозволяє безпосередньо судити про створення позитронія в речовині.

Структурна схема установки для спостереження 3γ -анігіляції показана на рис. 1.4. Три сцинтиляційних детектора розміщені в одній площині під кутом 120 ° один до одного на однаковій відстані від зразка з джерелом. Таке розташування детекторів відповідає реєстрації трьох γ -квантів від одного акту 3γ -анігіляції з однаковою енергією (по (2/3) $m_0c^2 = 340$ кеВ). Вимірювання ймовірності $P_{3\gamma}$ зазвичай проводять щодо алюмінію, в якому позитроній свідомо не утворюється; тому $P_{3\gamma}^{A1} \approx P_{3\gamma}^0 = 0,27\%$. Детальний опис схеми, установки і методики наведено в роботах [1, 25].



Рис.1.4. Схема установки для спостереження трьохфотонної анігіляції: 1 – кристал, 2 – *Pb*-коліматор, 3 – ФЕУ, 4 – схема швидких збігів (10 нс), 5 – тригер, 6 – схема повільних збігів (1 мкс), 7 – амплітудний аналізатор [68]

Поряд з прямими методами визначення відносної ймовірності 3γ – анігіляції $P_{3\gamma}$ за швидкістю підрахунку збігу трьох γ -квантів існують непрямі методи. Одним таким методом є вимір енергетичного спектра анігіляційного випромінювання (застосовується один детектор, імпульси з виходу детектора подаються на амплітудний аналізатор). Цей метод використовується в роботах [1, 15]. І нарешті, відносну ймовірність *Зу*–анігіляції можна визначити по зростанню швидкості рахунку збігів двох ү-квантів при зменшенні ймовірності *Зу*– анігіляції, наприклад через магнітного гасіння позитронія.

1.5 Визначення ймовірності 2у-анігіляції позитронів

Метод визначення ймовірності 2γ -анігіляції позитронів, заснований на вимірюванні кутового розподілу анігіляційних фотонів [1 – 6, 10]. При анігіляції електрон – позитронної пари виконується закон збереження зарядової парності. З цього випливає, що при 2γ - анігіляції спочиває позитрон – електронної пари, обидва γ -кванта розлітаються в протилежних напрямках (кут розльоту дорівнює 180 °) з однаковою енергією γ –квантів m₀c²=0.511 MeB. Якщо імпульс пари ρ не дорівнює нулю, то кути (див. рис. 1.5) між напрямками розльоту γ –квантів відрізняються від 180 ° на величину (1.9) (в лабораторної системі координат), а їх енергія вже не дорівнює 0,511 MeB.

Діапазон зміни кута θ дуже малий (менше 1 °), тому кутом розльоту зазвичай називають не сам кут θ , а його відхилення від 180 °. Розподіл по кутах θ називають кутовим розподілом анігіляційних фотонів (КРАФ). Якщо імпульс пари $p \ll m_0 c$, то кут θ визначається співвідношенням

$$\theta = \frac{p_\perp}{m_0 c} \tag{1.19}$$

Допплерівське розширення ДЕ анігіляційної лінії дається виразом

$$\Delta E_{\gamma} = \frac{p_{\parallel}c}{2} \tag{1.20}$$

де $p_{\perp} p_{\parallel}$ і поперечна і поздовжня складові імпульсу p відповідно (див. рис. 1.1).

Таким чином, вимірювання швидкості рахунку збігів γ – квантів при 2 γ – анігіляції в залежності від кута θ (відхилення кута розльоту γ – квантів від 180 °) або допплерівського розширення анігіляційної лінії (0,511 MeB) ΔE_{γ} дозволяє визначити імпульс $e+e^{-}$ пар (або електронів, якщо імпульс позитрона малий у порівнянні з імпульсом електрона).

Схема установки для вимірювання кутових розподілів анігіляційних фотонів представлена на рис. 1.5. [1–6]. Позитрони з радіоактивного джерела 2 потрапляють в досліджувану речовину 3 і анігілюють там з випусканням двох γ -квантів. Ці кванти розлітаються в різні боки під деяким кутом один до одного і реєструються детекторами. Сигнали з детекторів 1 і 4 через підсилювач 6, дискримінатор 7, схему збігів 8 потрапляють на лічильник 9, реєструючий події, пов'язані з одночасним попаданням анігіляційних γ -квантів в обидва детектора. Вхідні вікна детекторів γ -квантів є щілини з кутовими розмірами θ_y і θ_z , Розташовані паралельно один одному і площині зразка по різні боки від зразка (така схема експерименту називається паралельно–щілинна).



Рис.1.5. Схема установки для спостереження кутової кореляції анігіляційних γ-квантів: 1 - рухливий детектор, 2 - джерело позитронів, 3 - зразок, 4 нерухомий детектор, 5 - сцинтилятор, 6 - підсилювач, 7 - дискримінатор, 8 – схема збігів, 9 – лічильник [68]

Умови, що накладаються на кутові розміри θ_y і θ_z мають вигляд

$$\theta_{\gamma} = \frac{\Delta p_{\gamma}}{m_e c} \gg 2 \frac{P_{max}}{m_e c}, \qquad \theta_z = \frac{\Delta p_z}{m_e c} \ll \frac{p_{max}}{m_e c}$$
(1.21)

Тут ΔP_y і ΔP_z - розширення установки по проекціях P_y і P_z імпульсу, m_e маса електрона, c – швидкість світла, P_{max} – максимальне значення імпульсу електрона в речовині.

Число γ–квантів, що реєструються одночасно двома детекторами (відбір таких випадків здійснюється схемою збігів (1.8), описується виразом

$$N_{c}(0) = A \int_{p_{z}-\frac{\Delta p_{z}}{2}}^{p_{z}+\frac{\Delta p_{z}}{2}} dp_{z} \int_{-\Delta p_{y}}^{+\Delta p_{y}} dp_{y} \int_{-\infty}^{+\infty} dp_{x} n_{e} (p_{x}, p_{y}, p_{z})$$
(1.22)

де А– нормувальна константа, $n_e (P_x, P_y, P_z)$ – щільність розподілу електронів за імпульсами в досліджуваній речовині. З огляду на умови (1.21), вираз (1.22) можна переписати у вигляді

$$N_c(\theta) = A \,\Delta p_z \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} dp_x dp_y n_e(p_x, p_y, p_z)$$
(1.23)

Зазвичай в якості КРАФ використовується не число збігів γ -квантів $N_c(\theta)$, а ймовірність $f(\theta)$. При цьому нормувальна константа A в (1.22) і (1.23) вибирається так, щоб виконувалася умова нормування

$$\int_{-\pi/2}^{+\pi/2} f(\theta) d\theta = 1$$
 (1.24)



Приклади КРАФ деяких металів приведені на рис. 6

Рис.1.6. Кутовий розподіл анігіляційних фотонів в зразках магнію, алюмінію, міді та індію. Штрихові криві – їх розкладання на параболічну (1) і гауссову

(2) компоненти; суцільна крива – сума компонент 1 і 2; точки –

експериментальні значення [68]

Таким чином, в паралельно-щілинний геометрії експерименту число збігів у-квантів представляє собою інтеграл від щільності розподілу електронів за проекціями імпульсу електрона, паралельним площині досліджуваного зразка. Це дає можливість проводити дослідження третьої проекції імпульсу електрона, перпендикулярної площині зразка

У разі сферичної симетрії імпульсного розподілу електронів з результатів експериментів з паралельно-щілинною геометрією можна знайти щільність розподілу електронів за імпульсами [1]

$$n_e(p) = \frac{A}{\theta} \frac{\delta f(\theta)}{\delta \theta}$$
(1.25)

де $p = \theta m_e c$ – імпульс електрона.

Кутовий дозвіл сучасних установок досягає 0,3 мрад при гарній статистиці (10^4 – 10^5 імпульсів на точку в максимумі кривої *f*(θ)), що дозволяє отримати детальну структуру кореляційних кривих (див., наприклад, [1, 6–8]). криві кутовий кореляції можуть містити вузьку і широку компоненти (рис. 7).



Рис.1.7.Кутовий розподіл анігіляційних γ–квантів: світлі кружечки – для чистого льоду при -40 ° C, темні кружечки – для чистої води при 20 ° C, штрихова крива – виправлений кутовий розподіл [68]

Своїм походженням вузька компонента зазвичай зобов'язана повільним атомам парапозитроній, а широка – анігіляції вільних позитронів або позитрона ортопозитронія на електронах середовища. При анігіляції повністю термалізованних атомів парапозитроній при кімнатній температурі відхилення кута двох анігіляційних γ -квантів від 180° для вузької компоненти складає всього $\theta \approx 0,5$ мрад, а для широкої – $\theta \approx 10$ мрад.

Експериментальні спектри добре описуються суперпозицією декількох гаусових функцій, а в разі металів до них додається параболічна складова. Кожна функція описує певний канал анігіляції позитронів і характеризується інтенсивністю (ймовірністю анігіляції) і дисперсією, однозначно пов'язаної з енергією анігілюють пари.

1.6 Допплерівське розширення анігіляційної лінії

Рух центру мас анігілюючої пари щодо системи координат обумовлює не тільки відхилення кута розльоту двох γ -квантів при 2 γ -анігіляції від 180 °, а й допплерівське розширення анігіляційної лінії 0,511 МеВ. Розвиток методу спостереження доплерівського розширення анігіляційної лінії мав певні перешкоди, такі , як відсутність ефективних детекторів з достатнім розширенням по енергії. Завдяки створенню напівпровідникових *Ge(Li)* – детекторів цей метод починають застосовувати поряд з методом кутової кореляції (див., наприклад, [1,2]).

Щоб спостерігати доплерівське розширення анігіляційної лінії використовувався Ge(Li) –детектор (зазвичай планарного типу об'ємом 2– Зсм³), імпульси з якого подаються на багатоканальний амплітудний аналізатор. На цей час роздільна здатність невелика: 1,3–2,3 кеВ, що відповідає кутовому розширенню установок для спостереження кутової кореляції γ –квантів ($\Delta\theta$ 4 – 9 мрад). Проте лінія анігіляційного випромінювання виявляється значно ширше кривої енергетичного дозволу. Результати вимірювання допплерівського розширення анігіляційної лінії в деяких металах і інших речовинах добре узгоджуються з даними по кутовій кореляції анігіляційних γ –квантів [1,2].

Якщо не зважати на порівняно невисоку роздільну здатність, допплерівського розширення має ряд переваг у порівнянні з методом кутової кореляції. Метод кутової кореляції потребує складної механічної системи для фіксації кута розльоту *γ*-квантів і потужного джерела позитронів для отримання хорошої статистики. При вивченні форми анігіляційної лінії ці вимоги відпадають.

РОЗДІЛ 2 АНІГІЛЯЦІЯ ПОЗИТРОНІВ В МЕТАЛАХ

Позитронна анігіляція посиленно досліджується в металах. Це пов'язано з тим, що цей метод дозволяє визначати такі важливі характеристики металів, як розподіл електронів за імпульсами, енергію рівня Фермі ε_F [eB], число вільних електронів Z_c , що припадають на один атом металу, і їх концентрацію n_p [см⁻³] в зоні провідності. Ці характеристики, як відомо, багато в чому визначають механічні, електричні і магнітні властивості металів.

У кристалічній решітці металу не всі валентні електрони пов'язані зі своїми атомами, деяка їх частина ($Z_c \ge 1$ на атом) рухлива в об'ємі металу і утворює електронний газ, в який як би занурений каркас з позитивних іонів. Електронний газ, в свою чергу, компенсує сили електростатичного відштовхування між іонами і пов'язує їх в тверде тіло (металевий зв'язок).

Для ідеальних і реальних (наприклад, полікристалічних зразків) металів числа електронів Z_c і їх концентрація n_p , безсумнівно, розрізняються. Тому в даній роботі представлені результати експериментальних досліджень позитронної анігіляції КРАФ для ряду полікристалічних зразків металів з метою з'ясування особливостей механізму анігіляції, визначення параметрів ε_F , Z_c , n_p і їх залежностей від природи металів.

2.1 Методика, теорія і результати експериментів

Вимірювання КРАФ проводилися на установці з паралельною геометрією реєстрації анігіляційних фотонів (див. рис. 1.5). Джерелом позитронів служив радіоактивний ізотоп ²²Na активністю 3,7*10⁹ Бк. Число збігів в максимумі становило майже про 2*10⁴. Досліджувані зразки розміром 10 * 20 * 10 мм³ вирізалися з цілих шматків металу і не піддавалися ніякій спеціальній обробці. Як приклад результатів проведених досліджень обрані Mg,Al,Ci,Zn,In,Sn,Pb,Bi.

В металах валентні електрони зазвичай поділяють на дві групи: електрони провідності (вільні електрони) і електрони, що знаходяться на іонних остовах атомів (пов'язані електрони). Електрони провідності мають імпульсний розподіл

$$n_e(p) = \left(exp\frac{\frac{p^2}{2m} - e_F}{k_B T} + 1\right)^{-1}$$
(2.1)

де *e_F* –енергія Фермі, *k_B*–стала Больцмана, *T*– термодинамічна температура.

Для низьких температур імпульсний розподіл електронів провідності близько до прямокутного. Звідси випливає, що спектри КРАФ полікристалічних металів повинні мати параболічну компоненту

$$f_p(\theta) = \begin{cases} \frac{3I_p}{4\theta_p^3} \left(\theta_p^2 - \theta^2\right) |\theta| \le \theta_p \\ 0, \qquad |\theta| > \theta_p \end{cases}$$
(2.2)

Дійсно, компонента (2.2) добре проявляється для всіх металів навіть при кімнатній температурі.

На рис 1.6 наведено спектри КРАФ ряду полікристалічних металів, отримані в експериментах. Частина, що залишилася після вирахування параболічної компоненти залежність $fg(\theta)$ досить добре описується кривою Гауса:

$$f_g(\theta) = \frac{I_g}{\sqrt{2\pi\theta_g}} exp\left(-\frac{\theta^2}{2\theta_g^2}\right)$$
(2.3)

Тут інтенсивності l_p і l_g параболічної і гаусової компоненти чисельно рівні відносної площі кожної з компонент в спектрі КРАФ, причому $l_p+l_g=1$, θ_g – дисперсія кривої Гаусса, θ_p – кут перетину параболічної кривої з віссю абсцис θ . Далі, використовуючи параметр θ_p (кут відсічення параболою осі абсцис θ , див. рис. 1.6, який визначається з експерименту, можна оцінити імпульс Фермі p_F і енергію Фермі ε_F досліджуваного металу:

$$P_F = \theta_p mc \tag{2.4}$$

$$\varepsilon_F = \theta_p^2 \frac{mc^2}{2} \tag{2.5}$$

У наближенні моделі вільного електронного газу параметр θ_p визначає число вільних електронів Z_c (число електронів провідності), що припадають на один атом металу, і їх концентрацію $n_p(\theta)$:

$$Z_c = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{mc^2}{h}\right)^3 \frac{A}{\rho N_A} \theta_p^3 \tag{2.6}$$

$$n_p(\theta) = Z_c na = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{mc^2}{h}\right) \theta_p^3$$
(2.7)

а також енергію електронів іонних «остовів» (тобто електронів, для яких спектри КРАФ має гаусовий розподіл):

$$\varepsilon_g = \frac{3}{2} \frac{mc^2}{2} \theta_g^2 \tag{2.8}$$

де *N*_A – стала Авогадро, *h* – стала Планка, *A* – атомна маса металу, *ρ* – густина.

Експериментально отримані значення параметрів Z_c , $\varepsilon_F n_p$ прийнято зіставляти з аналогічними параметрами для ідеального металу. Будемо вважати ідеальним такий метал, в якому всі валентні електрони перебувають в зоні провідності. В цьому випадку число електронів провідності Z_c , що припадають на один атом металу, визначається номером групи Періодичної системи елементів Менделєєва. При цьому в рамках моделі вільного електронного газу, енергія Фермі ε_F і концентрація електронів провідності n_p , є його константами:

$$\varepsilon_{\rm F} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} n_A Z_c\right)^{\frac{2}{3}} \tag{2.9}$$

$$n_{\rm p} = Z_c n_A = \frac{N_a \rho}{A} Z_c \tag{2.10}$$

де *n*_A – число атомів в одиниці об'єму металу[55]

2.2 Особливості спектрів КРАФ досліджених металів

Виміряні спектри КРАФ в магнії, алюмінії, міді і індії і їх розкладання на параболічну і гаусову компоненти (штрихові криві) показані на рис. 1.6. Суцільна крива є сумою цих компонент і добре описує експеримент. Параметри розкладання КРАФ досліджених металів, а також алюмінію і міді з роботи [15] наведені в табл.2.1 (значень інтенсивності I_g не наведено, тому що $I_g=1-I_p$)

Таблиця 2.1.

Основні характеристики металів і параметри анігіляції позитронів [68]

Характеристика	Mg	Al	Cu	Zn	In	Sn	Pb	Bi
Zc	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00
$n_{\rm A}, 10^{22} {\rm Cm}^{-3}$	4,30	6,00	8,40	6,50	3,80	3,60	3,30	2,80
λ_{exp} , Hc^{-1}	4,44	6,13	8,80	6,76	5,08	4,98	5,15	4,27
$\theta_{\rm p}^{\rm exp}$, мрад	5,41	6,83	5,50	5,85	5,77	6,15	5,62	6,01
			5,57					
θ_{g}^{exp} , мрад	4,63	4,46	4,84	4,85	4,43	5,02	4,63	4,72
		6,40 [37]	6,31 [37]					
$\theta_{g}^{\text{theor}}$, мрад	3,50	4,30	2,80	3,50	4,00	4,70	3,80	4,30
I _p	0,72	0,69	0,38	0,45	0,56	0,64	0,41	0,55
$n_{\rm p}(au),10^{22}~{ m cm}^{-3}$	43,10	57,20	45,90	41,10	38,50	43,40	28,60	31,50
$n_{\rm p}(\theta), 10^{22} \ {\rm cm}^{-3}$	9,40	18,80	10,30	11,90	11,40	13,80	10,50	12,90
$n_{\rm p},10^{22}~{\rm cm}^{-3}$	8,60	18,10	8,45	13,10	11,50	14,50	13,20	14,10
φ	2,15	2,85	2,30	2,05	1,93	2,17	1,40	1,50
f	4,60	3,10	4,50	3,50	3,40	3,20	2,70	2,50
$\varepsilon_{\rm F}^{\rm exp}$, eB	7,50	11,60	8,00	8,70	8,50	9,60	8,00	9,20
e_g^{exp} , eB	8,20	7,60	8,90	9,00	7,50	9,60	8,20	8,40
		15,60	15,2					
^ε _F , eB	7,10	11,60	7,00	9,40	8,60	10,00	9,40	9,90

(погрішність визначення $\theta_p \theta_g$ і $I_p I_g$ не перевищують 0,5 і 5% відповідно)

З таблиці 2.1 видно, що значення інтенсивностей гаусом (I_g) і параболічної (I_p) компонент можна порівняти, тобто позитрони з досить високою ймовірністю взаємодіють як з валентними електронами іонних остовів, так і з електронами зони провідності. Високе значення інтенсивності I_p обумовлено, очевидно, тією обставиною, що позитрон в металі оточений своєрідною "шубою" електронів (за рахунок кулонівського тяжіння позитроном електронів провідності), що приводить до його екранування.

В цілому вважається що в металі утворюється негативно заряджений комплекс типу комплексу Уілера $Ps^{-\eta}$, ефективний заряд η (-*e*) якого залежить від природи металу. Тут η (-*e*) - ефективний заряд іона в частках заряду електрона. Такого роду комплекс і валентні електрони іонних «остовів» можуть дуже добре взаємодіяти з утворенням релаксируючих метастабільних квазіатомних систем $Ps^{-\eta}$, Включаючи валентні електрони в області іонного

остова і іонний остов, за аналогією з утворенням квазіатомних систем позитрон–аніон в іонних кристалах, що і зумовлює високі значення гаусових компоненти I_g (див. табл. 2.1).

В області іонних «остовів» електронні хвильові функції комплексу Ps⁻ трансформуються в електронні атомні хвильові функції зовнішніх валентних електронів, а позитронну хвильову функцію слабозв'язаного позитрона (якщо виключити перебування позитрона на ядрі іона металу) можна вибрати у вигляді хвильової функції слабозв'язаного оптичного позитрона [13].

У наближенні слейтеровскіх орбіталей електронних хвильових функцій [13] і позитронної хвильової функції цього типу напівширину Γ_g на напіввисоті кривих КРАФ (див. рис.1.6) можна обчислити за формулою [17]

$$N(t) = \int R(t, t_1) \sum_{i=1}^{n} A_i exp\left(-\frac{t_1}{\tau_1}\right) dt_1$$
 (2.11)

$$\Gamma_g = \frac{1}{2} C_{n(s,p,d)} \beta_{n(s,p,d)} \tag{2.12}$$

де $C_{n(s,p,d)}$ -перевідний множник: $C_{2(s,p)}=3,52$, $C_{3(s,p)}=2.86$, $C_{4(s,p)}=2,52$, $C_{5(s,p)}=2.48$, $C_{6(s,p)}\approx 2$

В_{n(s,p,d)} слейтерівські параметри електронних *n(s,p,d)* орбіталей атомів. Ширина дисперсії кривою Гауса, дорівнює:

$$\theta_g = \frac{\Gamma_g}{\sqrt{2ln^2}} = 0.85 \ \Gamma_g \tag{2.13}$$

У таблиці 2.1. наведені розраховані за формулою (2.12) і експериментальні значення θ_g (*n* (*s*, *p*)) для дослідженого ряду металів. Збіг розрахованих і експериментальних значень θ_g цілком задовільний, що вказує на розумний характер обраного механізму анігіляції в металах.

2.3 Визначення концентрації електронів *n_p* в зоні провідності металу

Як зазначалося, концентрація електронів провідності n_p є важливою характеристикою металевого стану. Для визначення значень n_p використовують різнобічні методи: електричні, оптичні, гальваномагнітні (наприклад, ефект Холла), вимірювання електронної частини теплоємності металу і поверхневого імпедансу на радіочастотах. Температурні залежності n_p дозволяють визначати значення p_F , ε_F і концентрацію електронів вільного електронного газу ($n_p = N/V$, де N – загальне число електронів, V – обсяг)

Метод анігіляції позитронів є прямим методом визначення концентрації n_p в металах. Виходячи з факту, що все позитрони в металах анігілюють в вільних зіткненнях, можна записати вираз для визначення значень n_p (θ) з спектрів КРАФ (див. табл. 2.1 і рис .1.6):

$$n_p(\theta) = 5.942 * 10^{20} \theta_p^3 [\text{cm}^{-3}]$$
(2.13)

Концентрацію електронів в зоні провідності можна також знайти, вимірюючи швидкість анігіляції позитронів в металах. Дійсно, в цьому випадку позитроній не утворюється і швидкість анігіляції позитронів визначається концентрацією електронів, з якими вони відчувають зіткнення:

$$\lambda_d = \sigma_d v n_e \tag{2.14}$$

де $\sigma_d = \pi r_0^2 / \beta = (\pi r_0^2 / v) c$ діраківський переріз 2ү–анагіляції ,*v*– швидкість позитрона, r_0 -класичний радіус електрона.

Розуміючи під *n_e* суму концентрацій електронів провідності *n_p* і «остовних» електронів *n_g*, вираз (2.14) можна записати у вигляді

$$\lambda_d = \lambda_p + \lambda_g \tag{2.15}$$

де λ_p і λ_g – швидкості анігіляції позитронів на електронах провідності і «остовних» електронах відповідно. Тоді ймовірності анігіляції по кожному з перерахованих каналів визначаються як

$$I_p = \frac{\lambda_p}{\lambda_p + \lambda_g} \tag{2.16}$$

$$I_g = \frac{\lambda_g}{\lambda_p + \lambda_g} \tag{2.17}$$

Вирази (2.13), (2.16) і (2.17) дозволяють знайти зв'язок між вимірюваної швидкістю анігіляції позитронів в металі $\lambda_{3M} = \lambda_d$ концентраціями електронів провідності n_p і «остовних» електронів n_g і відповідними ймовірностями анігіляції I_p і I_g , які визначаються в кутових експериментах:

$$n_p(\tau) = \frac{\lambda_{i_{3M}} I_p}{\pi r_0^2 c} = 1.354 * 10^{23} \lambda_{i_{3M}} I_p[cm^{-3}]$$
(2.18)

$$n_g(\tau) = \frac{\lambda_{i_{3M}} I_g}{\pi r_0^2 c} = 1.354 * 10^{23} \lambda_{i_{3M}} I_g[cm^{-3}]$$
(2.19)

де $\lambda_{3M} = 1/\tau_{3M}$ сумарна швидкість анігіляції позитронів, τ_{3M} – вимірюваний час життя, I_p і I_g – відносні площі під параболою і гаусинами в спектрах КРАФ (див. рис.1.6).

Відзначимо, що в формулах (2.13), (2.18) і (2.19) параметри O і O_g мають розмірність мрад, а λ_{3M} – нс⁻¹ Таким чином, вирази (2.13) і (2.18), так само як і вираз (2.10), дозволяють оцінити концентрацію електронів провідності n_p , Але вже з використанням результатів вимірювання параметрів анігіляції позитронів.

У таблиці 2.1. наведені концентрації електронів провідності, визначені за даними КРАФ з (2.13), вимірам швидкості анігіляції позитронів в (2.18) і концентрацій для ідеальних металів (2.10): $n_p(\theta)$, $n_p(\tau)$ і n_p . Порівняння цих концентрацій вказує на близькість значень $n_p(\theta)$ і n_p і суттєва відмінність їх від значень $n_p(\tau)$. У зв'язку з цим фактор

$$f = \frac{n_p(\tau)}{n_p(\theta)} = \frac{Z_c(\tau)}{Z_c(\theta_p)}$$
(2.20)

який характеризує, на нашу думку, збільшення електронної щільності в області знаходження позитрона порівняно з електронної щільністю вільного електронного газу. Як видно з табл. 2.1, значення параметра f для досліджених металів лежить в інтервалі 2,5–4,6.

Можна сказати те, що взаємодія позитронів з електронним газом призводить до локального підвищення концентрації електронів і в наслідок чого збільшується швидкість анігіляції позитронів. В цей час збільшення електронної щільності, не позначається помітним чином на значені імпульсу та енергії електронів (а отже, і θ_p), що входять до складу комплекса Ps⁻¹, так як спектр КРАФ, що описує анігіляцію з цього комплексу добре апроксимується параболою, а експериментально певне значення енергії Фермі цілком задовільно узгоджується з теоретичним. Таким чином, можна вважати, що значення концентрації електронів, які визначаються за формулою (39) з використанням тільки даних КРАФ, найбільш вірогідно відображають значення концентрації n_p вільного електронного газу. Це дійсно має місце (див. табл. 2.1)

Ефективний заряд η комплексу Уілера Ps^{- η} можна оцінити, порівнюючи концентрацію n_p (τ) електронів в області знаходження позитрона з концентрацією

$$(Ps) = \frac{3}{4\pi} r_{Ps}^{-3} = 2 * 10^{23} \text{cm}^{-3}$$
(2.21)

вільному атомі позитронія ($r_{Ps}1.06*10^{-8}$ см — радіус борівської орбіти позитронія). Відношення цих величин $\phi = n_p/n(Ps)$ наведено в табл. 1. Значення параметра ϕ усереднене за усіма дослідженими металами, виявилося рівним

2,04. Очевидно, що ефективний заряд η пов'язаний з параметром ϕ формальним співвідношенням $\eta = \phi - 1, \eta \approx 1$, як і повинно бути в комплексі Уілера.

Таким чином, механізм анігіляції позитронів в металах через утворення комплексів Уілера, очевидно, знаходить експериментальне підтвердження. Під кінець можна зазначити те, що метод кутового розподілу анігіляційних фотонів дає можливість визначати параметри електронного газу в металах $(n_p, \varepsilon_F, Z_c)$ та досить добре узгоджується з аналогічними параметрами які отримуються з теорії вільного фермі–газу. Цього ж часу комбінація методів кутового і часового розподілу анігіляційних фотонів дозволяє отримувати інформацію про збільшення електронної щільності в місці знаходження позитрона

РОЗДІЛ З

ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ

Адаптивність структури матеріалів при високотемпературному відпалі дозволяє спрогнозувати їх властивості при високих температурах, а також визначити їх ресурс роботи. Низька термічна стабільність, є одним з недоліків однофазних наноструктурних конденсованих матеріалів нітридів перехідних металів, яка погано позначилася на мікроструктурі, так і на фізико-хімічних властивостях. Покриття, що розглядалися, містять зерна, оточені кордонами, які, з'єднують поверхню покриття, схильного атмосферного окислення, з підкладкою. Щоб підвищити термічну стійкість треба домогтися усунення взаємодії зерен із середовищем через кордони, які оточують їх, а також більш високої стійкості до розкладання метало-нітриду.

Для усунення цього недоліку є метод введення в основний матеріал легуючих добавок. Одним з прикладів є додавання Al в нітрідній системи (TiN, ZrN, CrN), що дозволяє істотно підвищити їх термічну плавучість за рахунок формування на поверхні покриття захисного шару Al_2O_3 . Наприклад, окислення $Al_xT_{i1-x}N$ буде відбуватися за допомогою дифузії атомів Al назовні з утворенням збагаченого алюмінієм шару оксиду на поверхні а також дифузії атомів кисню всередину покриття, які утворюють збагачений титаном шар. Як наслідок створюється подвійний захисний шар зовнішній шар – Al_2O_3 і внутрішній – TiO_2). Ще варто зазначити, що досягнення найбільш високої термостабільності можливо шляхом розробки не тільки потрійних систем, але і четверних. Так в статті [58] було показано, що додаткове легування покриття $Ti1-_xAl_xN$ атомів Cr та Y підвищує їх термічну стабільність до температур вище 950 °C. Як наслідок деякі незначні зміни фазового складу покриття не дають змоги просуванню атомів кисню всередину покриття і атомів елементів з підкладки.

Особливий інтерес на який було звернено увагу, це новий клас металевих з'єднань – високоентропійних сплавів, що має не менше 5 складових

елементів. Головною особливістю цих сплавів є висока ентропія змішання, що дає змогу не тільки зберігати систему в даному стані, але і термічну стабільність фазового складу і структурного стану, а отже, фізико-механічні властивості нітридних покриттів. В результаті чого зменшена вільна енергія дає змогу зберегти твердий розчин заміщення як після кристалізації, так і після термічної обробки.

З іншої точки зору наявність чималого вибору складових елементів з різними електронними конструкціями, розмірами може призводити до небезпечних спотворень кристалічної решітки. Це може призвести до неабиякого твердорозчинного зміцнення і підвищення термічної стійкості. Так, значущі флуктуації потенційної енергії, викликані різноманітністю складових атомів, а також висока густина упаковки набагато зменшують ефективну дифузійну відстань. При значних викривленнях решітки вагомо підвищується вільна енергія, скорочується енергія між зернами ,a, отже і рушійна сила їх збільшення В наслідок термічного впливу для нітридних покриттів високоентропійних сплавів притаманне зростання зерен і стабільність структури.

Згідно з інформацією [59] дослідження термостійкості на повітрі (*TiVCrZrHf*)N нітридних покриттів високоентропійних сплавів проявили збій фазової стабільності при температурі відпалу 500 °C. При отриманні температури в 600 °C оболонка повністю окислюється з отриманням $ZrTiO_4$ оксиду (товщина становить 3160 нм). Застосування в системі таких тугоплавких елементів, як *Nb*, *Hf*, повинно позитивно відбитися на термічній стабільності одержуваних оболонок.

Термічний відпал покриттів відбувався протягом 30 хвилин в печі Vacutherm-Ceram VT 1200 при температурі 873 К і тиску залишкової атмосфери 100 Ра. Для зразків були відібрані покриття, які були отримані в різних умовах осадження, а саме при найбільшому і найменшому тиску робочого газу і потенціалах зміщення підкладки (№ 508 – *PN* = 0,1 Па, Uсм = 100 В, № 504 – *PN* = 0,7 па, Uсм = 200 В). Структурно-фазовий зміна зразків в результаті термічного відпалу показано на рис. 3.1.

Відомості рентгенодифракційного аналізу зразка 504-й серії показують, що при однофазному початковому стані створюється чітка текстура з віссю [60] вертикально площині зростання (рис. 3.1). За даними рентгенівської тензометрії з'ясовано що для покриття 504-й серії характерна найвища величина періоду решітки в ненапруженому перетині (a = 0,442 нм),що гарно корелює з результатами елементного аналізу, завдяки яким при високому робочому тиску в момент отримання покриттів відзначається найвища концентрація азоту.

Розгляд фазового складу конденсатів системи (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N показав відсутність чималих змін структурно-фазового стану оболонок в результаті термічного відпалу (рис. 3.1 а). Відповідно до оцінок розміру OKP з даних XRD до відпалу методом Дебая-Шеррер було виявлено що їх розмір становить близько (55 – 58) нм.

У шаруванні, яке було отримано при меншому тиску $P_N = 0,1$ Па, спостерігається укорочування періоду решітки в ненапружених перетинах до 0,438 нм, що можна висвітлювати меншим вмістом атомів азоту в покритті. В наслідок термічного відпалу цієї серії зразків відбувається крихітна зміна фазового складу (рис.3.1 б, крива 2), а саме появі нових піків, які відповідають окислам



Рис. 3.1. Ділянки рентгенодифракційних спектрів покриттів, отриманих при різних умовах осадження, до (1) і після термічного відпалу 873 К (2): а – зразок № 504; б – зразок № 508 [70]

На рисунку добре видно пониження інтенсивності (порівняємо спектри 1 і 2 на (рис. 3.1 б) від текстурованих рефлексів ГЦК металевої кристалічної решітки по типу *NaCl* (октаедричні позиції в металевій ГЦК кристалічній решітці зайняті атомами азоту), а також поява реакцій на малих кутах, відповідних утворенню оксидів *TiO*₂ (JCPDS 01-0562) і оксиду типу *MeTiO*₄, де *Me* відповідає змісту *Zr* і *Hf* елементам. За структурним типом такий оксид схожий ізоструктурним *ZrTiO*₄ (JCPDS 07-0290) і *HfTiO*₄ (JCPDS 14-0103). Величина кристалітів для покриття даної серії становить (48 – 55) нм.

Розгляд термостійкості з позиції термодинаміки можливо шляхом аналізу даних, представлених в *табл.*3.1.

Таблиця 3.1

Ентальпія утворення оксидів і нітридів складових елементів (Ti-Hf-Zr-V-Nb) N нітрідного покриття [70]

	TiN	TiO ₂	ZrN	ZrO ₂	VN	V ₂ O ₅	HfN	HfO ₂	NbN	NbO
∆Н, кДж/моль	- 337	-977	- 365	- 1100	- 217	-775	- 373	- 1144	-234	-405

З отриманої інформації (*табл.* 3.1) видно, що рушійні сили формування оксидів або нітридів для складових елементів різняться. Так, зокрема бінарні нітрид *TiN*, *ZrN* і *HfN* більш схильні до окислення (максимальна роль ентальпії змішування) чим решта елементів що роз'яснює створення таких оксидів як TiO_2 і *MeTiO*₄, де *Me* відповідає змісту *Zr* і *Hf*. Дивлячись на те, що елементи Zr і Hf хімічно подібні один з одним і мають майже однакові атомні радіуси, роблячи висновок можна припустити, що оксид типу *MeTiO*₄ є *ZrTiO*₄ і *HfTiO*₄ є оксидами.

Як відмічалося раніше одним з більш ефективних і сприйнятливих методів вивчення вільних обсягів у нанокристалічних покриттях є анігіляція

позитронів. Чутливість даного методу складає від 10⁻⁶ до 10⁻³ дефектів на 1 атом [64]. Так як розмір зерен в нанокристалічних матеріалах становить набагато менше ніж довжина пробігу позитрона в бездефектному кристалі(100 нм), то захоплення позитронів зазвичай відбувається на кордоні двох сусідніх зерен, що дає змогу провести аналіз меж розділу. Треба пам'ятати, що позитрони в нанокристалах також захоплюються вакансійними кластерами, дислокаціями, вакансіями металевої і неметалічної підрешіток, в стиках трьох сусідніх кристалітів і ін. [64].

Для аналізу дефектів вакансійного покриття використовували повільний позитронний мікропромінь. S-параметр доплерівського розширення піку анігіляції вимірювався залежно від падаючої енергії позитронного пучка (до 30 кэВ), тобто на глибину аналізу [67]. Він визначається як площа центральної частини низького імпульсу спектра (AS), поділена на площу нижче всієї кривої (Ao) після віднімання фону:

$$s = \frac{A_s}{A_o}, \quad A_s = \int_{E_o - E_s}^{E_o + E_s} N_D dE$$
 (3.1)

Вимірювання зміни енергії позитрону дозволяє визначити концентрацію дефектів як функції глибини проникнення, тобто вимірювання профілів глибини дефекту.

На рис. 3.1 наведені результати позитронної анігіляції, а саме залежності S-параметра від енергії для зразків № 504 і № 508 до і після термічного відпалу при температурі 873 К.



Рис. 3.1. Залежності S-параметра доплерівського розширення анігіляційного піку (Дуап), виміряного по глибині покриття (Ti-Hf-Zr-V-Nb) N (а - № 504, б - № 508), до і після відпалу 873 К [70]

Варто вказати, що S-параметр має залежність як від концентрації, так і від типу вакансійних дефектів, на яких здійснюється захоплення позитронів з подальшою їх анігіляцією в областях зі зниженою електронною густиною на вакансійних дефектах. У випадку бездефектного матеріалу величина *S* становить 0,5 нм.

З отриманого результату (рис. 3.1) видно, що профілі дефектів (Sпараметр) мають сильну різницю для № 504 і № 508 зразків. Ця різниця з фізичної точки зору обумовлено різноманітними параметрами осадження Так, зразок № 504 придатний до більш високого радіаційного впливу (після впливу більш високого потенціалу зміщення – Uсм = 200 В), що показує наявність вищої деформації, тоді як відпалений зразок № 504 при потенціалі зсуву Uсм = 200 В менш деформований, що виражається в зменшенні концентрації дефектів. Так, для № 504 S–параметр від (0,58 – 0,53). Для зразка № 508 (рис. 3.9 б) з розгляду залежності S-параметра в початковому стані (після осадження) можемо спостерігати що в покритті майже відсутні позитроночутливі дефекти по всій глибині аналізу покриття, мається на увазі те, що анігіляція йде в основному з електронами в бездефектних ділянках покриття, тому величина *S*–параметра мінімальна і становить 0,49.

Цього часу термічній відпал при температурі 873 К в камері з досить високим залишковим атмосферним тиском (100 Ра) приводить до кардинальних змін *S*-параметра по глибині покриття. Для зразку № 504 величина *S*-параметра після відпалу зменшується від (0,58 – 0,56) до (0,52 – 0,51), і збільшення величини *S*-параметра до значення 0,53 можемо бачити тільки тоді, коли енергія аналізуючих позитронів буде близькою до (12,5 – 15) кеВ. Помітне зменшення *S*-параметра після відпалу в порівнянні з вихідним станом пов'язано з релаксацією дефектів ходом перерозподілу елементів у покритті (рис.3.2).



Рис. 3.2. Карти розподілу елементів в покритті(Ti-Hf-Zr-V-Nb)N (504 серія): а – вихідний стан; б – після термічного відпалу 873 К [70]

У випадку зразка № 508 термічній відпал зближує до збільшення величини S-параметра до 0,53 в області приповерхневого шару покриття, а пізніше при зростанні глибин аналізу. Під час росту енергії позитронів від 14 до 17 кеВ величина S-параметра сильніше зростає і надходить до найбільшого можливого значення 0,59. За присутністю цього піку, очевидно, зумовлено примножування процесів діфузії атомів кисню вглиб оболонки і появі оксидів типу $MeTiO_4$, які представляють собою $ZrTiO_4$ і $HfTiO_4$ з'єднання, а також оксиду типу TiO_2 .

РОЗДІЛ 4

Основні правила техніки безпеки та охорони праці при роботі з персональним комп'ютером

Загальні вимоги. Джерелом небезпеки для життя при роботі з комп'ютерами є напруга живлення 220 — 380 В. До роботи з комп'ютерами допускаються особи, які: а) ознайомилися з інструкцією щодо роботи з ЕОМ і отримали інструктаж на робочому місці;

б) засвоїли відповідний практичний курс, необхідний для роботи за комп'ютерами.

2. Вимоги безпеки при роботі за пультами ЕОМ:

 а) при роботі з ЕОМ необхідно пам'ятати, що в них є напруга, небезпечна для життя.
 16 КВ — постійна напруга на електропроменевій трубці; змінна напруга 220 В, 50 Гц — напруга живлення мережі;

б) у зв'язку з цим необхідно суворо дотримуватися таких вимог техніки безпеки:

— не вмикати і не вимикати роз'єми кабелів при поданій напрузі живлення;

— не залишати комп'ютери під живленням без нагляду;

в) перед вмиканням ЕОМ у мережу необхідно переконатись:

— у наявності заземлення приладів;

 — у справності шнура живлення, шнура зв'язку клавіатури з блоком живлення;

— увімкнути живлення.

При ураженні струмом треба діяти негайно (див.: Техніка безпеки при користуванні електроприладами).

3. У разі виникнення пожежі необхідно:

 а) використати всі наявні засоби пожежогасіння, крім води і вогнегасника ОХП-10; б) при необхідності викликати пожежну команду телефоном 01.

4. Категорично забороняється:

а) включати ЕОМ у розетку при несправному шнурі живлення;

б) під'єднувати і роз'єднувати роз'єми кабелів;

в) проводити будь-який ремонт під час включення ЕОМ.

5. Вимога безпеки після закінчення роботи:

а) після закінчення роботи на ЕОМ необхідно відключити живлення;

б) слід пам'ятати, що після включення індикатора (виключення індикатора) частина схеми перебуває під напругою 220 В. Під час роботи за комп'ютером мають місце такі небезпечні та шкідливі фактори:

Фізичні:

— підвищене значення напруги електричного кола;

— підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

підвищений рівень статичної електрики;

— підвищений рівень іонізації повітря.

Психофізіологічні:

— статичні та динамічні перевантаження;

— розумове перенапруження;

— перенапруження зору при роботі за екранами пристроїв.

Рекомендації щодо організації робочого місця та захисту від шкідливого впливу комп'ютера на здоров'я людини:

 положення тіла повинно відповідати напрямку погляду, неправильна поза призводить до виникнення згорблення;

— нижній край екрана повинен бути на 20 см нижче рівня очей;

— рівень верхньої кромки екрана повинен бути на висоті чола;

— екран комп'ютера — на відстані 75—120 см від очей;

— висота клавіатури повинна бути встановлена таким чином, щоб кисті рук користувача розміщувались прямо;

— спинка стільця повинна підтримувати спину користувача;

— кут між стегнами і хребтом має становити 90°;

 — крісло та клавіатуру розміщують таким чином, щоб не було потреби далеко витягуватись;

— відстань між столами з комп'ютерами повинна бути не менша 1,5 м,
 між моніторами — 2,2 м;

якщо під час роботи доводиться дивитись на документи, то підставку
 з оригіналом документа слід встановлювати в одній площині з екраном і на одній з ним висоті;

 треба уникати яскравого освітлення, не втомлювати очі різкою зміною потужності світлових потоків;

— екран комп'ютера треба розміщувати під прямим кутом до вікон, самі вікна під час роботи доцільно завішувати або закривати жалюзями;

— у робочому приміщенні доцільно збільшувати вологість (оптимальна вологість — 60% при температурі 21° С), розмістити квіти, акваріум у радіусі 1,5 м від комп'ютера.

Рекомендації щодо режиму роботи:

— при введенні даних, редагуванні програм, читанні інформації з екрана безперервна робота за екраном монітора не повинна перевищувати 4-х годин при восьмигодинному робочому дні; кількість опрацьованих символів (знаків) не повинна перевищувати 30000 за 4 години роботи;

— через кожну годину праці необхідно робити перерву на 5—10 хв., а через 2 години —15 хв., під час яких доцільно виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики та провести сеанс психофізіологічного розвантаження.

Висновки

Метод позитронної анігіляції є багатообіцяючим методом контролю структури технічно цінних матеріалів, які використовуються в різноманітних областях науки і техніки. А сама суть методу ПАС полягає в тому, що позитрон, імплантують в досліджувану речовину, для зняття характеристик їх анігіляційних гамма-випромінювань. ПАС є неруйнівним методом вивчення структури речовини, що використовує позитрон в якості зонда.

Метод ПАС посилено досліджується в металах, бо це зв'язано з тим, що цей метод дає змогу визначати такі важливі особливості металів, як розподіл електронів за імпульсами, енергію рівня Фермі ε_F [eB], число вільних електронів Z_c , що припадають на один атом металу, і їх концентрацію n_p [см⁻³] в зоні провідності.

Для покриття 504 величина S-параметра після відпалювання зменшується від (0,58 - 0,56) до (0,52 - 0,51), і збільшення величини Sпараметра до значення 0,53 спостерігається тільки тоді, коли енергія позитронів наближається до (12,5 - 15) кеВ. Зменшення S-параметра після відпалювання в порівнянні з вихідним станом пов'язано з релаксацією дефектів шляхом перерозподілу елементів в покритті.

У разі зразка 508 термічне відпалювання приводить до збільшення величини S-параметра до 0,53 в області приповерхневого шару покриття, а потім при збільшенні глибини аналізу. При підвищенні енергії позитронів від 14 до 17 кеВ величина S-параметра ще більше зростає і наближається до максимально можливого значення 0,59. Наявність такого піку, очевидно, обумовлено посиленням процесів дифузії атомів кисню вглиб покриття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гольданский, В.И. Физическая химия позитрона и позитрония / В.И. Гольданский ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – М. : Наука, 1968. – 176 с

 Арифов У. А., Арифов П. У., Физика медленных позитронов / А.У Арифов; П.У. Арифов; Фан , Ташкент , 1971. – 244 с.

3. Седов В. Л., УФН / В.Л. Седов ; Российская Федерация , Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова *1968. – 22 с.*

4. West, R. N. (1979). Positron Studies of Lattice Defects in Metals. Positrons in Solids, 89–144. [Електронний ресурс] - Режим доступу: URL: <u>sci</u>hub.st/10.1007/978-3-642-81316-0_3 56 с

5. Dekhtyar I. Ya., *Phys. Rep.*, **9** (1974) [Електронний ресурс] - Режим доступу: URL: <u>sci-hub.st/10.1016/0370-1573(74)90021-0</u>111 с

6. Hautojarvi P. (Ed.), *Positrons in Solids (Topics in Current Physics, Vol. 12),* Springer-Verlag, Berlin, 1979 [Електронний ресурс] - Режим доступу: URL: <u>sci-hub.st/10.1007/978-3-642-81316-0</u>266 с

7. Jain P. C., Singru R. M., Gopinathan K. P. (Eds.), *Proc. 7th Intern. Conf. on Positron Annihilation, India, 1985*, World Scientific, Singapore, 1985

8. Dorikens-Vanpraet L., Dorikens M., Segers D. (Eds.), *Proc. 8th Intern. Conf. on Positron Annihilation, Belgium, 1988*, World Scientific, Singapore, 1988

9. Schultz P. J., Lynn K. G., *Rev. Mod. Phys.*, **60** (1988), [Електронний ресурс]
- Режим доступу: URL: <u>sci-hub.st/10.1103/RevModPhys.60.701</u> 81 с

Brandt W., *Appl. Phys.*, **5** (1974), [Електронний ресурс] - Режим доступу:
 URL: <u>sci-hub.st/10.1007/BF01193389</u>23 с

11. Прокопьев Е. П. и др., Позитроника ионных кристаллов, полупроводников и металлов, Ред.-изд. отдел МИЭТ, М., 1999

12. Фирсов В. Г. и др., Современные проблемы ядерной физики, физики и химии конденсированных сред. Тр. Первой Моск. междунар. школы физики

ИТЭФ, г. Звенигород Моск. обл., 17 - 26 февр. 1998 Прокопьев Е. П., Астрон. журн., **70** (1994),

13. Prokop'ev E. P., 10th Intern. Conf. on Positron Annihilation, Beijing, China, May 23 - 29, 1994, Abstracts, 24

14. Mills A. P. (Jr.), *Phys. Rev. Lett.*, **41** (1978)

15. Арефьев К. П., Воробьев С. А., Прокопьев Е. П., Позитроника в радиационном материаловедении ионных структур и полупроводников, Энергоатомиздат, М., 1983

16. Графутин В. И. и др., ФТТ, **40** (1998)

17. Графутин В. И. и др., ФТТ, **41** (1999)

18. Графутин В. И. и др., *Хим. физ.*, **19** (2000)

19. Графутин В. И. и др., *Хим. выс. энерг.*, **34** (2000)

20. Goldanskii V. I. et al., *Struct. Chem.*, **2** (1991)

Новиков Ю. А., Раков А. В., Шантарович В. П., Поверхность, 1991, № 6,
 34; ФТТ, **36** (1994)

22. Графутин В. И. и др., Изв. РАН. Сер. Физ., 58 (1994)

23. Ramasamy P., Nagaragian T., Physica B, 81 (1976), 305; Phys. Status Solidi,
35 (1976)

24. Арифов П. У. и др., Квантовые свойства атомов и ионов и позитронная диагностика, ФАН, Ташкент, 1975

25. Арефьев К. П. и др., Позитронсодержащие системы и позитронная диагностика, ФАН, Ташкент, 1978

 Воробьев С. А., Прохождение бета-частиц через кристаллы, Атомиздат, М., 1975

27. Seeger A., Appl. Phys., **4** (1974)

28. De Benedetti S., Nuovo Cimento Suppl., **4** (1956)

29. Прокопьев Е. П. и др., Хим. выс. энерг., **29** (1995)

30. Прокопьев Е. П., Хим. выс. энерг., **29** (1995)

31. Прокопьев Е. П., Поверхность, 1994, № 4, 117 с

32. Прокопьев Е. П., Поверхность, 1994, № 5, 5 с

- 33. Арефьев К. П., Прокопьев Е. П., Изв. вузов. Сер. Физ., 1990, № 5, 52 с
- 34. Прокопьев Е. П., Хим. выс. энерг., **24** (1990)
- 35. Прокопьев Е. П., Письма в ЖТФ, **16** (1990)
- 36. Прокопьев Е. П., Хим. выс. энерг., **28** (1994)
- Prokop'ev E. P., 10th Intern. Conf. on Positron Annihilation, Beijing, China, May 23 - 29, 1994, Abstracts, 2
- 38. Prokop'ev E. P., 10th Intern. Conf. on Positron Annihilation, Beijing, China, May 23 29, 1994, Abstracts, 24
- 39. Прокопьев Е. П., Поверхность, 1994, № 12, 54 с
- 40. Прокопьев Е. П., Поверхность, 1995, № 7-8, 5 с
- 41. Прокопьев Е. П., Хим. выс. энерг., **30** (1996)
- 42. Прокопьев Е. П., Шантарович В. П., Хим. выс. энерг., 30 (1996)
- 43. Прокопьев Е. П., Хим. физ., **16** (1997)
- 44. Прокопьев Е. П., Хим. выс. энерг., **31** (1997)
- 45. Прокопьев Е. П., Изв. вузов. Сер. Физ., 1997, № 2, 23 с
- 46. Прокопьев Е. П., Физ. и хим. обработки матер., 4 (1992)
- 47. Прокопьев Е. П., Письма в ЖТФ, **18** (1992)
- 48. Прокопьев Е. П., ЖПХ, 66 (1993)
- 49. Прокопьев Е. П., Изв. вузов. Сер. Химия и хим. технол., **36** (1993)
- 50. Прокопьев Е. П., Изв. вузов. Сер. Химия и хим. технол., 37 (1994)
- 51. Прокопьев Е. П., Высокочистые вещества, 5 (1995)
- 52. Прокопьев Е. П., Хим. физ., **15** (1996)
- 53. Прокопьев Е. П., Хим. выс. энерг., **28** (1994)
- 54. Киттель Ч., Введение в физику твердого тела, Наука, М., 1978
- 55. Ferrante G., Phys. Rev., **170** (1968)
- 56. Wheeler J. A., Ann. N.Y. Acad. Sci., 48 (1946)

57. Microstructure and oxidation resistance of $Ti_{1-x-y-z}Al_xCr_yY_zN$ layers grown by combined steered-arc/unbalanced-magnetron-sputter deposition / L.A. Donohue, I.J. Smith, W.-D. Munz [et al.] // surf. Coat. Technol. – 1997. – Vol. 94-95. – P. 226-231.

58. Oxidation resistance and structural evolution of (TiVCrZrHf)N coatings / D.C. Tsai, Z.C. Chang, L.Y. Kuo [et al.] // Thin Solid Films. – 2013. – Vol. 544. – P. 580–587.

59. Lai C.H. Influence of substrate temperature on structure and mechanical, properties of multi-element (AlCrTaTiZr)N coatings / C.H. Lai, M.H. Tsai, S.J. Lin, J.W. Yeh // Surf. Coat. Technol. – 2007. – Vol. 201. – P. 6993-6998

60. Huang P. Inhibition of grain coarsening up to 1000°C in (AlCrNbSiTiV)N superhard coatings / P. Huang, J.W. Yeh // Scripta Mater. – 2010. – Vol. 62. – P. 105-108.

61. Lai C.H. Preparation and characterization of AlCrTaTiZr multi-element nitride coatings / C.H. Lai, S.J. Lin, J.W. Yeh, S.Y. Chang // Surf. Coat. Technol. – 2006. – Vol. 201. – P. 3275-3280.

62. Influence of substrate bias, deposition temperature and post-deposition annealing on the structure and properties of multi-principal-component (AlCrMoSiTi)N coatings / H.W. Chang, P.K. Huang, J.W. Yeh [et al.] // Surf. Coat. Technol. – 2008. – Vol. 202. – P. 3360–3366.

Бусев А.И. Наноматериали, наноструктуры, нанотехнологии / А.И.
 Гусев. – М.: Физматлит, 2005. – 416 с.

64. Sundgren J.E. Structure and properties of TiN coatings / J.E. Sundgren // Thin Solid Films. – 1995. – Vol. 128. – P. 21-44.

65. 111 Lai C.H. Influence of substrate temperature on structure and mechanical, properties of multi-element (AlCrTaTiZr)N coatings / C.H. Lai, M.H. Tsai, S.J. Lin, J.W. Yeh // Surf. Coat. Technol. – 2007. – Vol. 201. – P. 6993-6998

66. R. Krause-Rehberg, H.S. Leipner, Positron Annihilation in Semiconductors, Springer-Verlag, Berlin, 1999.

67. A.D. Pogrebnjak et al. / Materials Chemistry and Physics 147 (2014) 1079e1091

68. И.Графутин, Е. П. Прокопьев Применение позитронной аннигиляционной спектроскопии для изучения строения вещества Институт

теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова, г. Москва УФН, (2002)

69. Microstructure, physical and chemical properties of nanostructured (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N coatings under different deposition conditions / A.D. Pogrebnjak, I.V. Yakushchenko, A.A. Bagdasaryan [et al.] // Mat. Chem. Phys. – 2014. – Vol. 147. – P.1079-1091. 2 c

 Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини Навч. посібник – Львів: Львівський банківський коледж, 1998. – 192 с.